

機部品と半導体の製造の促進計画 (SPECS)

1. バックグラウンド

インド政府の「Make in India」プログラムと「デジタルインド」プログラムの重要な柱の1つであるため、政府は電子機器のハードウェア製造に高い優先度を付けています。インドのエレクトロニクス製造業は現在、エレクトロニクス製造のさまざまなセグメントやバリューチェーンのさまざまな段階で競合する経済と比較して、8~10%の障害に直面しています。

1.2 国内の電子機器製造はここ数年で相当に増加し、セミノックダウン (SKD) レベルから完全ノックダウン (CKD) レベルの製造に着実に移行しています。しかし、国内の付加価値は依然として低く、10~30%の範囲に過ぎません。これは、国内に電子部品製造エコシステムの不足、半導体製造エコシステムの不足、ディスプレイ製造エコシステムの不足のためです。国内の電子機器製造の主な成長は、主に国内需要に応えるために、輸入された電子部品/サブアセンブリ/部品からの完成品の組立てにより発生しています。

1.3 国内付加価値の高い電子製品の製造にはサプライチェーンの開発が不可欠です。2019年2月25日に通知されたエレクトロニクスに関する国家政策2019 (NPE 2019) のビジョンは、チップセットを含むコアコンポーネントを開発する国の能力を奨励および推進することにより、インドをエレクトロニクスシステム設計および製造 (ESDM) のグローバル

ハブとして位置づけることで、そして業界がグローバルに競争できる環境を作り出すことです。

1.4 電機と半導体の製造は資本集約的であり、急変している技術に対応しなければなりません。部品は電機にの中心あでもあり、部品表の総額のかなりの部分を占めています。健全な電子機器製造環境は、長期間の持続可能な成長のためと収支を黒字にするため欠かせないものです。

1.5 製造分野に投資を誘致するのに重要な支障をきたしているのは、WTOの情報技術協定のもとで、電気部品と半導体のほとんどが関税制度（BCD）に「無税」になることをはじめ、グローバル規模に合わせるため高い資本コストと、競争性のある電気と水の信頼性や品質や利用可能性などの不足と、サプライチェーンの不足と物流の高コストと、技術不足です。

1.6 改善された特別インセンティブパッケージ計画は金銭的インセンティブを与えて、支障と先行投資コストを補正するあげく、電機製造業界に投資を誘致します。この計画の新プロジェクトと拡張プロジェクトの申請期間は2018年12月31日まででした。この計画のもとに、電機製造施設の建設助成金が与えられます（SEZ区の中の建設に20%とSEZ区の外は25%）M-SIPSはインドで電機製造の促進に重大な役割をはたしています。

2. (SPECS)電機部品と半導体の製造の促進計画 (SPECS)

2.1 電機部品と半導体の製造の促進の計画 (SPECS) のもとに電気機器のサプライチェーンを含むリストに定めたように、製造のために資本投資の25%がインセンティブが与えられると提案されました。

3. 目的

3.1 この計画で、部品と半導体の国内製造における支障を補正したあげく、国内の製造環境の強化を果たします。

4. 適任性

4.1 SPECSは、新しいユニットへの投資だけでなく、既存のユニットの容量の拡張/近代化と多様化にも適用できます。

5. 限界値

5.1 投資するため最低限のしきい値は付属されています

5.2 新ユニットと既存のユニットの容積の拡張または、モダン化、多様化のしきい値は同じである。

5.3 インセンティブが与えられたしきい値/部品リストにもし、変更があった場合定期的な見直しが行われます。

6. 計画の期間

6.1 通知の期日からSPECSの申請期間は3年間有効です。申し込まれた申請は継続的に評価され、実施は計画のもとの承認によります。

7. 計画下のインセンティブ

7.1 付属されたリストにある部品に投資しているユニットには資本投資の25%があたえられます。インセンティブが弁償金として与えられます。

7.2 資本支出は工場、機会、設備、関連する施設、技術と研究開支の合計になります。このような適格である資本支出についての仔細は基準に述べられます。この度、国内か海外に調達したにもかかわらず、改装された工場、機械、設備（関連する施設とR&Dを含め）の総額が有資格のある工場、機械、設備（関連する施設とR&Dを含め）の総額の20%を超えなければ、インセンティブの計算が検討されます。

7.3 州政府や州政府の機関に与えられたインセンティブは計画のインセンティブ以上でなければいけません。

7.4 申請者はインド政府のほかの計画に属することもできます。しかし、M-SIPSに請求済みのあるインセンティブの投資はSPECSの有資格の投資ですとして認められません。

8. 許可と支出額の手続き

8.1 インドに登録している会社/機関は計画に申請ができます

8.2 全ての申請は新投資と独立志願として扱われます。申請はシングルフェーズプロジェクトのみが承認され。各工程の申請は検討されません。申込者には複数なところで申請できます。

8.3 あらゆる点で完成された、締め切り前に提出した最初の申請は継続的に評し、承認のために検討されます。

8.4 計画のインセンティブは申請の承認の日付から有効です。承認は申請の最初の細見をしてから発細されます。申請の承認はSPECS による承認というわけではありません。

8.5 インセンティブは、申請の承認日から5年以内に行われた投資に利用できます。

8.6 有資格の設備投資に対するインセンティブの支払いは設備投資の閾値価格と商業生産の開始をを上回っているかどうかを検討上で、申請の承認後にされます。インセンティブの次の請求は六ヶ月ごとに出されます。

。

8.7 SPECS に インセンティブもらっているユニットは商業生産開始の日付から短くとも3年間、または最後のインセンティブの領収日付から1年間商業生産を続かなければなりません。

9. 管理の仕掛け

9.1 このスキームは、ノード機関によって実施されます。ノード機関はアプリケーションの評価を行います。

9.2 このような節点機関はプロジェクト管理機関（PMA）として勤め、度々電子情報技術省に委託された業務と秘書や管理や実施のサポートをするのは義務付けられています。PMAの作動と責任は電子情報技術省に発行された計画基盤に詳述しています。

9.3 SPECS の実施に関する作動を施行するために、PMAは以下のとりわけをする

9.3.1. 計画による支援のために申請をうけとり、承認を発行し、値踏みをして、申込者の資格を確認します。

9.3.2 出費の請求を受け、インセンティブを承認された申請に出費します。

9.3.3 スキームの進捗状況とパフォーマンスに関する定期的なレポートをMeitYに提出します。

9.4 PMAは電子情報技術省を占める計画責任委員会（EC）の前に値踏みされて、有資格と承認した申請を置きます。ECは電子情報技術省の長官以上の役員が代表します。ECは適切な部や省や機関の代表を占めます。ECの詳細な規則、作動と責任は計画の基盤に詳細されています。

9.5 ECは申請の認可/不採用/変更のためにPMAを推薦します。ECの推薦によって、コピーが電子情報技術省にあって、PMAは申込者に承諾書を発行されます

9.6 電子情報技術省は計画に基づく認可をえた事業にインセンティブを出すために予算規定を作るべきです。インセンティブは金融規則と認可条件によってPMAに出費されます。PMAはプロジェクトの原則ではなく定期的に電子情報技術省に予算要件を提出します。

9.7 スキームの進捗状況は、MeitY書記長の議長の下でMeitYによって構成される管理審議会（GC）によりレビューされます。GCは政府と業界の専門家で構成されます。GCは、スキームとそのプロジェクトの進捗状況を定期的にレビューします。GCは、スキームの実施を成功させるために、スキームガイドラインの改訂を随時実施することが認められています。GCの詳細な構成、機能、および責任については、スキームガイドラインで詳しく説明します。

9.8 スキームの下でインセンティブに対して資格がある商品のリストは、適用されるしきい値とともに、管理審議会によって随時見直され、修正されるものとします。

9.9 SPECSスキームを効果的に機能させるために、評価および支払いガイドラインがMeitYによって作成され、個別に発行されるものとします。

9.10 スキームの中間評価は、指定された目的の観点から、業界と経済によって得られる利益を評価するために行われるものとします。

SPECSの下でインセンティブに対して資格がある商品のリスト

A. 最小投資しきい値の制限が5000万ルピーの商品のリスト

S.No	商品の説明
1.	LEDチップを含むSMTコンポーネント
2.	スマートカード用のチップモジュール、RFIDアンテナおよびラベル、CoB /システム・イン・パッケージ
3.	電子アプリケーション用の抵抗器、コンデンサ、フェライトなどの受動部品
4.	電子アプリケーション用のトランス、インダクター、コイル、リレー、スイッチ、マイクロモーター、ステッピングモーター、BLDCモーター、コネクタ、ヒートシンク、アンテナ、スピーカー、マイクなどの電気機械部品
5.	電子部品用のマグネトロン、ウェーブガイド、サーキュレーター、カプラー、アイソレーター、フィルター、マグネット、RFコンポーネント
6.	プリント基板 (PCB) 、PCBラミネート、プリペグ、フォトポリマーフィルム、PCB印刷インキ; プリンテッドフレキシブルエレクトロニクス
7.	電子アプリケーション用のセンサー、トランスデューサー、アクチュエーター、クリスタル
8.	カメラモジュール、バイブレーターモーター/リンガー
9.	USB /データケーブル、HDMIケーブル
10.	SPECSの下のすべての商品の資本財

B. 最小投資しきい値の制限が1.5億ルピーの商品のリスト

W-18/30/2019-IPHW-Meity

電子情報技術省

(IPHW区)

S. No.	商品の説明
1.	活性成分: a. トランジスタ、ダイオードなどを含む個別の半導体デバイス b. FET、MOSFET、サイリスタなどを含むパワー半導体
2.	シリカと光ファイバーのプリフォーム
3.	ディスプレイアセンブリおよびタッチパネル/カバーガラスアセンブリ

C. 最小投資しきい値の制限が2.5億ルピーの商品のリスト

S. No.	商品の説明
1.	マイクロ電気機械システム (MEMS) やナノ電気機械システム (NEMS) などのようなマイクロ/ナノ電子コンポーネント
2.	アセンブリ、テスト、マーキング、パッケージング (ATMP) ユニット

D. 最小投資しきい値の制限が7.5億ルピーの商品のリスト

S. No.	商品の説明
1.	電子アプリケーション用の機械 (プラスチックおよび金属部品)

E. 最小投資しきい値の制限が25億ルピーの商品のリスト

S. No.	商品の説明
1.	GaN、SiC、GaAsなどの化合物半導体およびシリコン・フォトニクス・デバイス/集積回路、オプトエレクトロニクス・コンポーネント

W-18/30/2019-IPHW-Meity

電子情報技術省

(IPHW区)

F. 最小投資しきい値の制限が50億ルピーの商品のリスト

S. No.	商品の説明
1.	半導体ウェーハ

G. 最小投資しきい値の制限が100億ルピーの商品のリスト

S. No.	商品の説明
1.	ロジックを含む半導体集積チップ (IC) [マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタルシグナルプロセッサ (DSP)、特定用途向け集積回路 (ASIC) など]; メモリ; アナログ/ミックスシグナルICなど
2.	電子アプリケーション用の液晶ディスプレイ (LCD)、発光ダイオード (LED)、有機発光ダイオード (OLED) などを含むディスプレイ製造ユニット
